

主催:一般社団法人日本ロボット工業会 Organizer: Д Japan Robot Association (JARA)

## Malcom

## 出展のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

弊社はこの度、"電子機器2019トータルソリューション展"内の"実装プロセステクノロジー展"に出展いたします。 今回はソルダペースト撹拌機<ソルダソフナ>の新製品をはじめ、好評いただいているディップテスタなど様々な製品を展示 させていただきます。

是非この機会にご関係者お誘い合わせのうえご来場下さいます様、心よりお待ちしております。

敬具

## ☆主な出展予定品目

- ペーストコントロールユニット PCU-285 (新製品) 静止型リフロー装置 (新製品)
- ソルダソフナ (新製品)
- ディップテスタ<セレクティブはんだ装置対応>
- リフローチェッカーシリーズ 微量スパイラル粘度計

他

## ☆日時及びブース位置

日時:6月5日(水)~7日(金) AM10:00~PM5:00

(最終日はPM4:00終了)

会場:東京ビッグサイト

場所:西1ホール ブースNo.1-307

株式会社 マルコム

本社 〒151-0071 東京都渋谷区本町4-15-10 TEL:03-3320-5611 FAX:03-3320-5615

URL: http://www.malcom.co.jp E-mail: sales@malcom.co.jp